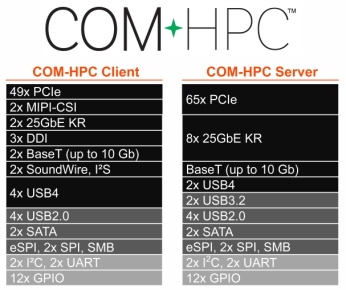
****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader enquiries:** | **Press contact:** |
| **congatec Japan K.K.** | **congatec Japan K.K.** |
| Yasuyuki Tanaka | Crysta Lee |
| Phone: +81-3-64359250 | Phone: +81-3-64359250 |
| [sales-jp@congatec.com](mailto:sales-jp@congatec.com)  www.congatec.jp | crysta.lee@congatec.com  www.congatec.jp |

******

***The pinout of the new COM-HPC standard***

*Text and photograph available at:* [*https://www.congatec.com/en/congatec/press-releases.html*](https://www.congatec.com/en/congatec/press-releases.html)

Press release

**PICMGのCOM-HPC小委員会の協議が進展**

**COM-HPCピン配列が承認される**

**Tokyo, Japan, 26 November 2019 \* \* \*** congatec（コンガテック ジャパン）は、PICMGのCOM-HPC技術小委員会が本日、高性能コンピュータ・オン・モジュールの新規格のピン配列を承認したことを発表します。このCOM-HPC新標準規格は、2020年の上半期に予定されているバージョン1.0規格の承認に向けて最終段階に入ります。COM-HPCワークグループに参加しているコンピュータ・オン・モジュールメーカーとキャリアボード設計者は、この事前承認されたデータに基づいた初期型エッジコンピューティングの設計に着手できます。これにより、Intel®とAMDが来年に予定する新しいハイエンドの組み込みプロセッサ世代の発売に合わせて市場投入できる見込みです。

PICMGの議長ジェシカ・イスクイス（Jessica Isquith）氏は、COM-HPC規格の進展を歓迎しています。「PICMGは現在、組み込みコンピューティングとエッジコンピューティングの分野で極めて重要な次世代コンピュータ・オン・モジュール規格の策定に取り組んでいます。ピン配列は物理的な専有面積の次に重要なゴールです。Intelなどの半導体メーカーをはじめとする重要な市場関係者全員を、COM-HPC技術小委員会に招集することができたおかげで、極めて短期間で事前承認に至り、また、この標準規格が将来のプロセッサ世代に可能な限り適合できるよう最善を尽くせました。

技術小委員会の議長を務めるcongatec（コンガテック）のクリスティアン・エダー（Christian Eder）は、次世代のハイエンド組み込みプロセッサが市場投入されるまでに、この規格が正式に承認されると確信しています。「コンピュータ・オン・モジュール新規格の策定は、多くの関係者が関わる複雑な作業です。ですが、2018年10月から正式な作業を開始できたため、次世代のハイエンド組み込みプロセッサの発売に合わせて、新しいCOM-HPCモジュール、キャリアボード、ソリューションプラットフォームを予定通りにリリースできることとなりました。これらは、ヘッドレスエッジサーバやより多機能なエッジクライアントソリューションに移行するための新しいソリューションで、既存のPICMG COM Expressモジュール標準規格を機能拡張します。

この度ピン配列が決定したことで、委員会のメンバー全員が、標準規格化されたCOM-HPCモジュールに最大100 GbE、PCIe Gen 4.0、Gen 5.0、最大8つのDIMMソケット、200ワット超の高速プロセッサを搭載するインターフェイスの提供や、標準規格準拠のキャリアボードの設計に向けて、確固たる作業基盤を得たことになります。

PICMG COM-HPC小委員会のメンバーには、独ビーレフェルト大学、Adlink、Advantech、Amphenol、AMI、congatec（コンガテック）、Elma Electronic、 Emerson Machine Automation Solutions, ept, Fastwel、GE Automation、HEITEC、Intel、Kontron、MEN、MSC Technologies、N.A.T.、Samtec、SECO、TE Connectivity、Trenz Electronic、VersaLogicが含まれます。Adlink、congatec（コンガテック）、Kontronは委員会のスポンサーも兼ねています。congatec（コンガテック）のマーケティング担当ディレクター クリスティアン・エダー（Christian Eder）がCOM-HPC小委員会の議長を務めています。エダー氏は、現行のCOM Express標準規格を策定する際もドラフトエディターを務めました。Kontronのステファン・ミルナー（Stefan Milnor）氏とSamtecのディラン・ラング（Dylan Lang）氏が、それぞれPICMG COM-HPC小委員会のエディターと秘書官として、クリスティアン・エダー（Christian Eder）をサポートします。

COM-HPCコンピュータ・オン・モジュールの新標準規格とピン配列についての詳細は、<https://www.congatec.com/COM-HPC>をご覧ください。

**congatec AGについて**

congatec AGはドイツのデッゲンドルフに本社を置くQseven、 COM Express、 SMARC 、SBCやODMサービスなどの産業用コンピュータモジュールの専業メーカです。congatecの製品は、産業用オートメーション、医療、アミューズメント、輸送、通信、計測機器やPOSなどの様々な用途に対応できます。コアな知識や技術ノウハウは、ドライバやBSPのみならずユニークなBIOS機能も含まれています。デザイン・インの段階以降も、製品のライフサイクル・マネジメントを通してサポートを提供いたします。弊社の製品は、現代の品質基準に従ったサービプロバイダのスペシャリストによって製造されています。現在、congatecは台湾、日本、米国、オーストラリア、チェコ共和国と中国に販売拠点があります。詳しくは、 www.congatec.jp へアクセスしてください。

\* \* \*

*Intel is a registered trademark of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*